



聯絡人

投資人關係

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

穩懋半導體公告 2019 年第一季自結財務報告

2019 年 4 月 25 日

穩懋半導體，全球最大砷化鎵晶圓代工服務公司，已於今(25)日公告 2019 年第一季自結財務報告。

2019 年第一季財務概況

- ◆ 本季合併營收新台幣 36.19 億元，較前季減少 14%，較去年同期減少 19%
- ◆ 本季合併毛利率為 25.0%，較前季減少 7.6 個百分點；
本季營業淨利率 8.3%，較前季減少 10.4 個百分點
- ◆ 本季營業淨利為新台幣 3 億元，較前季減少 62%，較去年同期減少 71%
- ◆ 本季稅後淨利為新台幣 1.51 億元，較前季及去年同期均減少 79%；
每股盈餘為新台幣 0.41 元，前季為新台幣 1.8 元

2019 年第二季展望

下列對於未來展望的表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。請參閱後附之「免責聲明」。

- ◆ 預計第二季營收將較第一季成長 mid-teens 百分比。
- ◆ 預計第二季毛利率預計約為 low thirties 的水準。

管理者評論

“2019年第一季在面臨產業傳統淡季及終端需求不振的影響之下，營收為新台幣36.19億元，季成長率及年成長率分別為 -14%及 -19%，產能利用率大約是在5成的水準，在產品組合未有明顯進步的情況之下，毛利率也如預期的在25%附近。營業費用則因研發及銷售費用略為提升而季增3%，第一季營業淨利率亦因此下滑到8.3%，我們認為淡季營收明顯下滑而導致第一季費用率攀高應屬短期現象。

回顧上一季法說會時，我們對於5G及3D感測將成為穩懋未來成長動能充滿信心的同時，我們也對於2019年短期所要面對的挑戰提出我們的看法。雖然我們提到，普遍認為5G的發展在2019年仍屬於初期的階段，不過，我們的確觀察到關於基礎建設的應用，相關客戶有更積極的5G開發專案及先期量產訂單，在第一季較為低迷的淡季中成為業績仍能同時維持季成長及年成長的產品族群。另外，在農曆年後我們陸陸續續看到來自亞洲的智慧型手機相關PA设计公司客戶增加了投片量，讓三月的業績有了顯著的提升，推升了第一季的營收略優於原先的預期，我們認為第一季應是今年營運的谷底，對於2019年全年展望具有相當的信心。

展望2019年第二季，預計營收將較第一季成長mid-teens百分比，預期毛利率約為low thirties的水準。”

關於穩懋半導體

穩懋半導體成立於1999年，位於林口華亞科技園區，是全球首座以六英吋晶圓生產砷化鎵微波積體電路(GaAs MMIC)的專業晶圓代工服務公司。穩懋擁有完整的技術團隊及最先進的砷化鎵微波電晶體及積體電路製造技術及生產設備，客戶群除了全球射頻積體電路设计公司(RFIC Design Houses)外，並致力吸引與全球整合元件製造(IDM)大廠合作。在製程技術發展方面，穩懋以多元化及領先為原則，期能提供客戶最完整的服務。在無線寬頻通訊的微波高科技領域中，穩懋目前提供兩大類砷化鎵電晶體製程技術：異質界面雙極性電晶體(HBT)和應變式異質界面高遷移率電晶體(pHEMT)，二者均為最尖端的製程技術。在光通訊及3D感測領域中，穩懋更以MMIC生產技術為基礎，提供光電產品的開發與生產製造。

免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。